

= US 2004/0233649



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 101 27 351 A 1**

⑤ Int. Cl. 7:  
**H 01 L 23/50**  
B 82 B 1/00

⑳ Aktenzeichen: 101 27 351.7  
㉔ Anmeldetag: 6. 6. 2001  
㉕ Offenlegungstag: 19. 12. 2002

DE 101 27 351 A 1

⑦ Anmelder:  
Infineon Technologies AG, 81669 München, DE  
⑦ Vertreter:  
Viering, Jentschura & Partner, 80538 München

⑦ Erfinder:  
Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE; Simbürger,  
Werner, Dr., 85540 Haar, DE; Hönlein, Wolfgang, Dr.,  
82008 Unterhaching, DE; Klose, Helmut, Dr., 81479  
München, DE

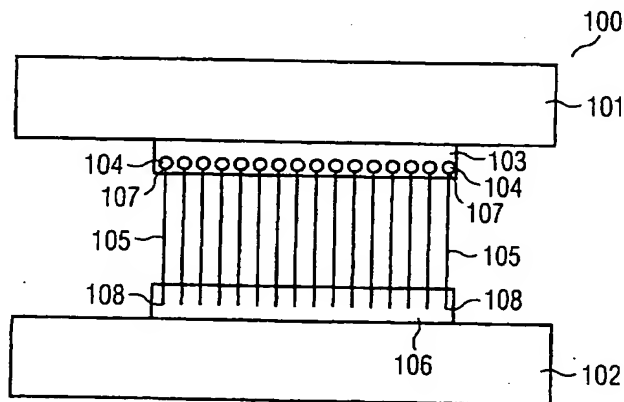
⑤ Entgegenhaltungen:  
US 60 20 742  
US 58 05 426  
EP 10 96 533 A1  
EP 10 87 413 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤ Elektronischer Chip und elektronische Chip-Anordnung

⑦ Auf mindestens einem externen Chip-Metallkontakt  
des elektronischen Chips ist eine Vielzahl von Nanoröh-  
ren aufgebracht zum Kontaktieren des elektronischen  
Chips mit einem weiteren elektronischen Chip.



DE 101 27 351 A 1